

高精度基板向け直接描画装置「Ledia8F」を発売

株式会社SCREEN PE ソリューションズはこのほど、5G通信関連やIoTインフラ、生成AIなどを中心に、需要が急速に拡大しているパッケージ基板やモジュール基板などの高精度基板に対応する、直接描画装置「Ledia 8F」を開発。2023年11月から販売を開始します。



Ledia 8F

☆この画像の印刷用データ（解像度300dpi）は、
下記URLよりダウンロードできます。
(www.screen.co.jp/about/nr-photo_2023)

近年、5G対応スマートフォンや車載・産業機器を中心としたIoTインフラ、生成AIの進展に伴い、これらの電子機器に搭載されるプリント基板の需要が急速に拡大しています。そのため、mSAP工法を用いたHDI基板、mSAP/SAP工法で製造されるモジュール基板、パッケージ基板などにおいて、これまで以上に高い描画位置合わせ精度が必要となってきています。

このような業界動向を背景に当社は、全世界で累計800台以上の導入実績を持ち、ブロード波長型直接描画装置としてデファクトスタンダード「Lediaシリーズ」の最新機種となる、高精度モデル「Ledia 8F」を開発しました。この装置は、業界で高い評価を得ている描画品質や安定性、独自の波長混合技術を継承し、装置構造を全面的に見直すことで、これまで以上に高い合わせ精度での描画を実現したモデルです。加えて、今回新たに「コンスタントキャリブレーション」を採用しており、露光処理中にバググラウンドで次の処理基板の位置合わせおよび補正処理を行えるため、装置パフォーマンスを最大限に発揮することができます。また、FC-BGA基板などに代表される高精度な描画品質が要求される基板に対応するなど、市場要求に応える汎用性の高い装置です。

今回の「Lediaシリーズ」のラインアップ拡充により、通信関連やIoTインフラを中心に拡大が続くプリント基板市場でのビジネスを加速させるとともに、今後も電子機器業界のさまざまなニーズに応え、同業界の発展に貢献していきます。

● 本件についてのお問い合わせ先

株式会社SCREEN PE ソリューションズ 営業統轄部 営業部 マーケティング課 Tel: 075-417-2704 pe-info@screen.co.jp